平成 24 年 2 月 28 日

各　位

会 社 名　TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社
代表者名　代表取締役社長　谷上 俊二
（コード番号:4687 東証一部）
問合せ先　取締役管理本部長　岩田 伸
（TEL:03-3350-8111）

エルピーダメモリ株式会社に対する債券の取立不能のおそれに関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 27 日付でエルピーダメモリ株式会社が、東京地方裁判所に対して会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同社の債券について、下記のとおり取立不能または取立遅延のおそれが生じましたのでお知らせいたします。

記

１．相手方の概要

（１）商号　エルピーダメモリ株式会社
（２）所在地　東京都中央区八重洲二丁目２番１号
（３）代表者の氏名　代表取締役社長　坂本幸雄
（４）資本金　2,361 億円（平成 23 年 9 月 30 日現在）
（５）事業の内容　半導体素子、集積回路等の電子部品の開発、設計、製造、販売および保守など

２．取立不能または取立遅延のおそれが生じた経緯

エルピーダメモリ株式会社が、平成 24 年 2 月 27 日、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申し立てを行い受理されました。

３．債券の種類、金額及び純資産に対する割合

（１）債券の種類　第 2 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（平成 17 年 3 月 22 日発行）
（２）金額　100 百万円
（３）純資産に対する割合　直近事業年度の末日（平成 23 年 3 月 31 日）の純資産（5,847 百万円）に対する割合　1.7％

４．今後の見通し

当該社債につき、平成 24 年 3 月期決算において特別損失として計上する予定であります。
なお、平成 24 年 3 月期の業績予想につきましては現在精査中であり、業績予想を見直す必要が生じた場合は適時に開示いたします。

以　上